

【11】證書號數：I663666

【45】公告日：中華民國 108 (2019) 年 06 月 21 日

【51】Int. Cl. : *H01L21/66 (2006.01)* *H05K3/00 (2006.01)*
 H05K1/02 (2006.01) *G01R31/26 (2014.01)*

發明

全 5 頁

【54】名稱：嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法

METHOD FOR MANUFACTURING INTERPOSER HAVING BURIED
 PASSIVE COMPONENTS

【21】申請案號：104126582

【22】申請日：中華民國 104 (2015) 年 08 月 14 日

【11】公開編號：201707097

【43】公開日期：中華民國 106 (2017) 年 02 月 16 日

【72】發明人：吳克興 (TW) WU, KO HSING；呂智韋 (TW) LU, CHIN WEI

【71】申請人：中華精測科技股份有限公司 CHUNGHWA PRECISION TEST TECH
 CO., LTD.

桃園市平鎮區工業三路 15 號

【74】代理人：張耀暉；莊志強

【56】參考文獻：

TW I285426

TW 200731889

TW 200829098

TW 201507088

US 2015/0124416A1

審查人員：陳聖

【57】申請專利範圍

1. 一種嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法，包括以下步驟：提供一轉接基板，該轉接基板具有一黏著層以及結合於該黏著層的相對二面上的兩個芯層，且該轉接基板中形成有一開槽，其中該轉接基板具有一第一表面及一相對於該第一表面的第二表面，且該開槽貫穿該第一表面及該第二表面；在該開槽中設置一被動元件，然後對該轉接基板施予熱處理以使該黏著層發生熱融，且熱融之該黏著層的一部分填充於該開槽中以結合該被動元件；以及在該轉接基板上形成一線路層，且該線路層通過該開槽以接觸該被動元件之一電極。
2. 如請求項 1 所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法，其中該被動元件包括一被動元件本體與分別設置於該被動元件本體兩端的一第一端電極及一第二端電極。
3. 如請求項 2 所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法，其中在該開槽中設置該被動元件的步驟中，該黏著層的該部分填充於該被動元件與該開槽之間的一間隙。
4. 如請求項 3 所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法，其中填充於該間隙的該黏著層的該部分圍繞包覆該被動元件的整個周邊邊緣與該第一端電極的一部分及該第二端電極的一部分。
5. 如請求項 3 所述的嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法，其中在該轉接基板上形成一線路層的步驟中，更包括以下步驟：形成一第一線路層於該第一表面上，且該第一線路層的一部分與外露的該第一端電極接觸；以及形成一第二線路層於該第二表面上，且該第二線路層的一部分與外露的該第二端電極接觸。

圖式簡單說明

圖 1 為本發明之嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法的流程圖。

(2)

圖 2 至圖 6 為本發明第一實施例之嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法的製程示意圖。

圖 7 至圖 10 為本發明第二實施例之嵌埋被動元件之轉接介面板結構的製造方法的製程示意圖。

圖 11 為根據本發明之圖測試介面組件的示意圖。

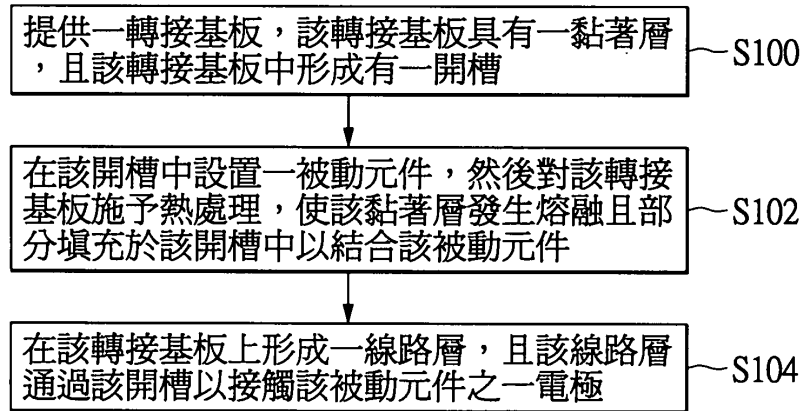


圖1

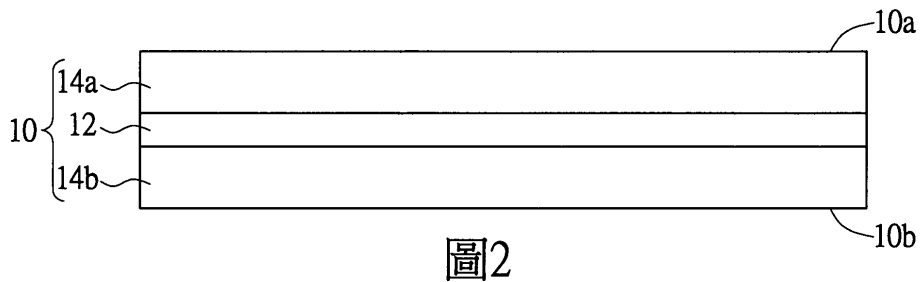


圖2

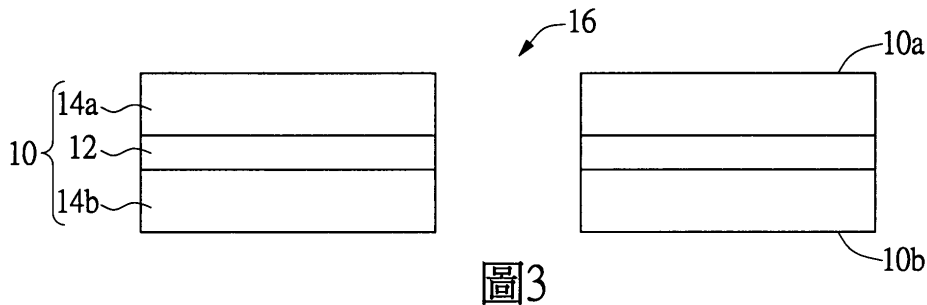


圖3

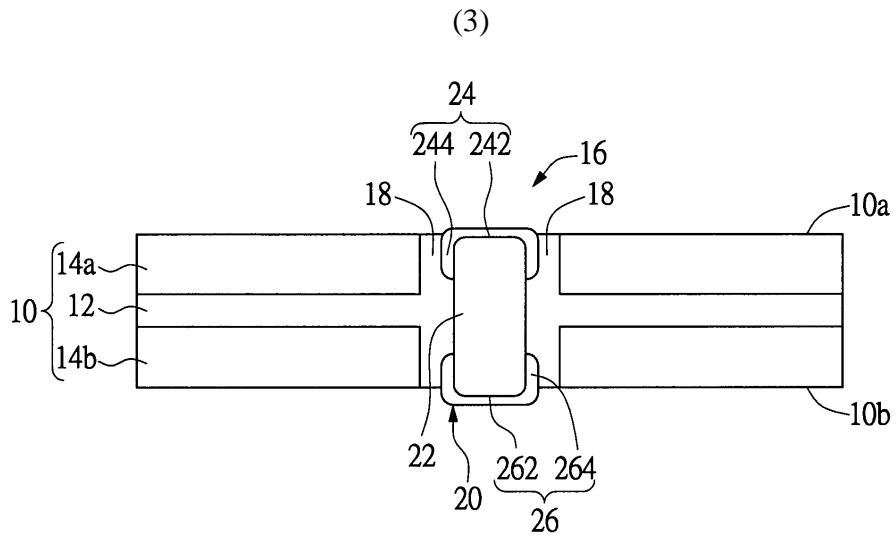


圖4

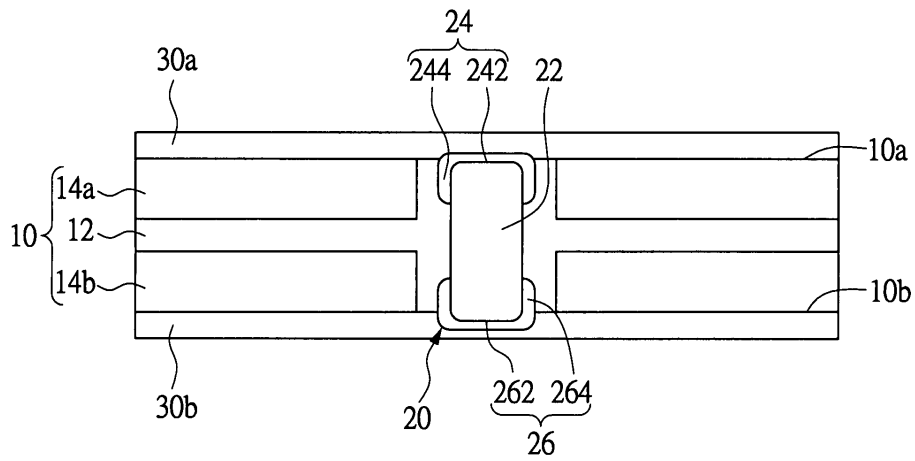


圖5

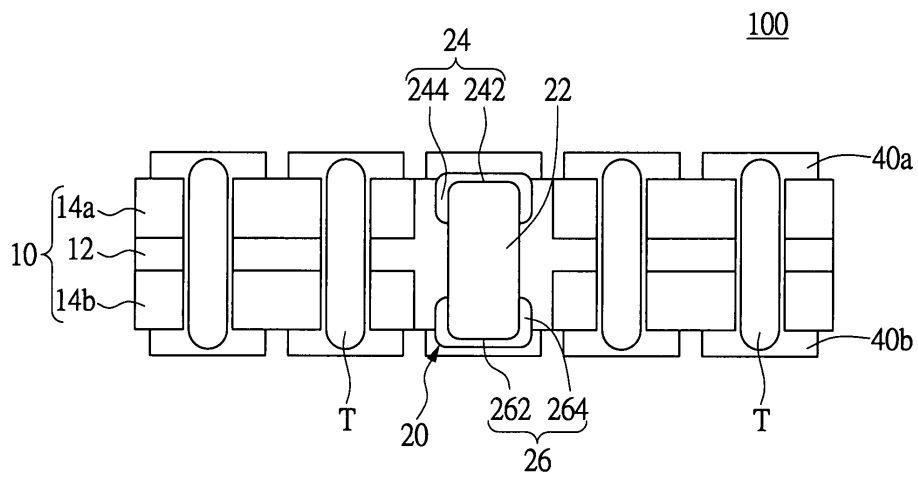


圖6

(4)

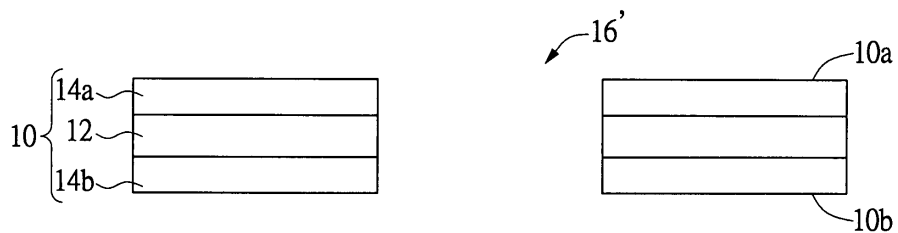


圖7

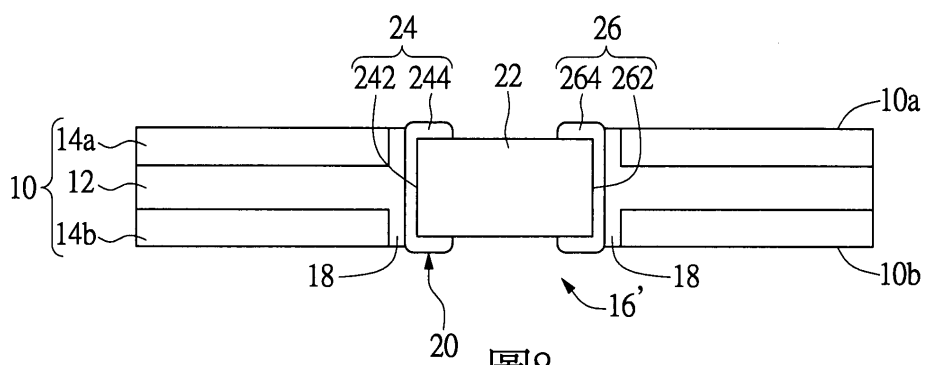


圖8

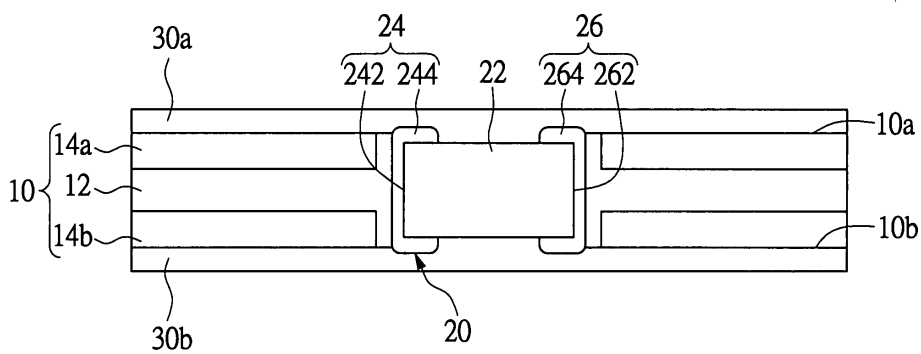


圖9

(5)

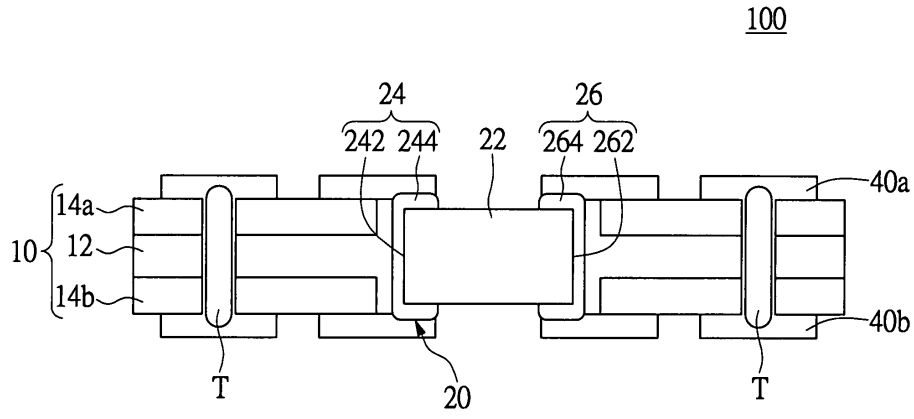


圖10

A

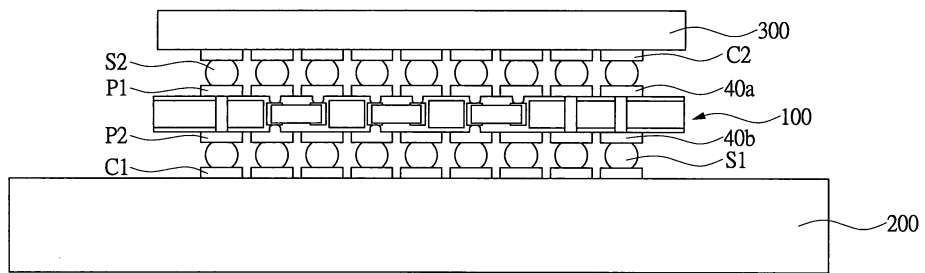


圖11